

## **TRABAJO PRÁCTICO N° 3 CIRCUITOS DE MEMORIA**

Indicar la organización y la tecnología de los siguientes circuitos integrados de memoria

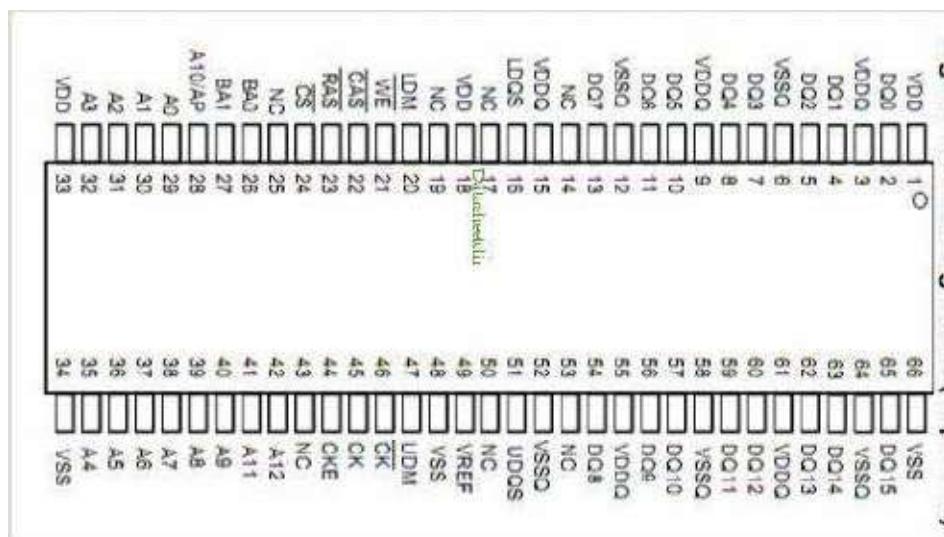
## PIN ASSIGNMENT

NC	1 •	28	VCC
A12	2	27	W
A7	3	26	E2
A6	4	25	A8
A5	5	24	A9
A4	6	23	A11
A3	7	22	̄G
A2	8	21	A10
A1	9	20	E1
A0	10	19	DQ7
DQ0	11	18	DQ6
DQ1	12	17	DQ5
DQ2	13	16	DQ4
VSS	14	15	DQ3

## Pin Configurations

A4	1	○	PN	44	A5
A3	2		ONE	43	A6
A2	3			42	A7
A1	4			41	OE
A0	5			40	UB
CE	6			39	LB
I/O0	7			38	I/O15
I/O1	8			37	I/O14
I/O2	9			36	I/O13
I/O3	10			35	I/O12
VCC	11			34	VGS
VSS	12			33	VCC
I/O4	13			32	I/O11
I/O5	14			31	I/O10
I/O6	15			30	I/O9
I/O7	16			29	I/O8
WE	17			28	NC
A16	18			27	A8
A15	19			26	A9
A14	20			25	A10
A13	21			24	A11
A12	22			23	A12

04L63W1A  
TSOP-II



Diseñar los siguientes bancos de memoria:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a) 128 Kbx 8 con CI de 32 Kb x 8 | d) 2Mb x 32 con CI de 512Kb x 16 |
| b) 2Mb x 8 con CI de 512Kb x 8   | e) 1Mb x 4 con CI de 1M Kb x 1   |
| c) 32 Mb x 8 con CI de 8 Mb x 8  | f) 16 Gb x 8 con CI de 4 Gb x 4  |